



2022 年 12 月 31 日現在

第 2 頁

※ 注 記 資料提供施設名等
 名称確認 名称取得施設名 名称 番号
 (施設コード) (コード) (コード) (施設)
 施設コード 名称取得施設名 名称 番号
 施設番号 000-000-0000

2022 年 12 月 31 日現在 (中間期) の通称登録件数及び 通称登録施設件数並びに配付件数に関する取組状況

2022 年 12 月 31 日現在 (中間期) の通称登録件数及び
 2022 年 12 月 31 日現在 (中間期) の通称登録施設件数並びに配付件数に関する取組状況は、下記の通り
 となります。

第 3 頁

1. 2022 年 12 月 31 日現在 (中間期) の通称登録件数に関する取組状況

(2022 年 12 月 31 日現在 (中間期) の通称登録件数に関する取組状況)

	件数	件数	件数	件数	件数
通称登録件数 (1)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
通称登録件数 (2)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
通称登録件数 (3)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
通称登録件数 (4)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
通称登録件数 (5)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
通称登録件数 (6)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111

② 2024 年 12 月末の設備投資計画と実績との対比

(2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日)

	対比額	設備計画	設備実績	固定資産の 増加額(円)	設備投資の 増加額(円)
総 計 (対 比 額)	27,000 (21,000)	27,000 1,000	27,000 1,000	27,000 100	27,000 (21,000)
半 導 体 部 門 (対 比 額)	15,000	1,000	1,000	0 円	15,000
機 器 部 門 (対 比 額)	12,000	0 円	0 円	0 円	
機 器 部 門 (対 比 額)	0 円	0 円	0 円	0 円	
機 器 部 門 (対 比 額)	0 円	0 円	0 円	0 円	
半 導 体 部 門 (対 比 額 対 比 額)	15,000	1,000	1,000	0 円	15,000

③ 設備投資の状況

	投資額(円)		
	固定資産	負債	合計
設備投資 (2023 年 4 月 1 日～)	27,000 円	27,000 円	27,000 円
半導体部門	27,000 円	27,000 円	27,000 円
設備投資	—	—	—
設備投資 (2023 年 4 月 1 日～)	27,000 円	27,000 円	27,000 円

④ 投資の概要

(1) 固定資産(半導体)：設備投資計画と実績

当社の固定資産(半導体)の増加は、主に、半導体の生産設備の増設と、半導体の製造設備の増設によるものであります。

当社の固定資産(半導体)の増加は、主に、半導体の生産設備の増設と、半導体の製造設備の増設によるものであります。

(2) 負債(半導体)：設備投資計画と実績

当社の負債(半導体)の増加は、主に、半導体の生産設備の増設と、半導体の製造設備の増設によるものであります。

当社の負債(半導体)の増加は、主に、半導体の生産設備の増設と、半導体の製造設備の増設によるものであります。

(3) 配当手続

当社は、株主の総額に対する剰余金の配当は総株主総会に諮問しており、総株主総会の決議を経て、取締役が総務部長に命じて金銭的に配当し、当社の一連事務の配当手続において「 $\times$ 」又は「 $\times$ 」と記載を付記しておきます。

この配当手続に当たって、2020年度は株主総会配当金、取締役会が「 $\times$ 」の金額に付して法的配当し、当株主が「 $\times$ 」の金額に配当いたします。

- (4) 上記の配当手続の範囲、当社の配当手続として「 $\times$ 」と記載及び「 $\times$ 」と記載であることと併せて一定の範囲に於いては、取締役が総務部長、当株主が「 $\times$ 」と記載に「 $\times$ 」と記載する旨の記載を付記いたします。